



Brüssel, den 21. November 2018  
(OR. en)

14559/18  
ADD 1

ENV 797  
MI 870  
DELECT 153

### ÜBERMITTLUNGSVERMERK

---

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	19. November 2018
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

---

Nr. Komm.dok.:	C(2018) 7499 final - Annex
Betr.:	ANHANG der Delegierten Richtlinie der Kommission zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen

---

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument C(2018) 7499 final - Annex.

---

Anl.: C(2018) 7499 final - Annex

Brüssel, den 16.11.2018  
C(2018) 7499 final

ANNEX

## ANHANG

der

**Delegierten Richtlinie der Kommission**

**zur Änderung — zwecks Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt — des Anhangs III der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme für Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen**

## ANHANG

Anhang III Eintrag 15 erhält folgende Fassung:

„15.	Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen	Gilt für die Kategorien 8, 9 und 11 und läuft ab am <ul style="list-style-type: none"><li>– 21. Juli 2021 für die Kategorien 8 und 9, ausgenommen medizinische In-vitro-Diagnostika und Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie;</li><li>– 21. Juli 2023 für die Kategorie 8 Medizinische In-vitro-Diagnostika;</li><li>– 21. Juli 2024 für die Kategorie 9 Überwachungs- und Kontrollinstrumente in der Industrie und für Kategorie 11.</li></ul>
15a.	Blei in Loten zum Herstellen einer stabilen elektrischen Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und dem Schaltungsträger in integrierten Flip-Chip-Baugruppen, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: <ul style="list-style-type: none"><li>– ein Halbleiter-Technologieknoten von 90 nm oder mehr;</li><li>– ein einzelner Chip mit einer Größe von 300 mm<sup>2</sup> oder mehr in jeglichem Halbleiter-Technologieknoten;</li><li>– gestapelte Chipbaugruppen mit einer Chipgröße von 300 mm<sup>2</sup> oder mehr oder Silizium-Interposer mit einer Größe von 300 mm<sup>2</sup> oder mehr.</li></ul>	Gilt für die Kategorien 1 bis 7 und 10 und läuft ab am 21. Juli 2021.“